

DGM

2. Ankündigung  
Anmeldung

# Verbund- werkstoffe

15. Symposium:  
Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde



6.-8. April 2005



Universität Kassel

Deutsche Gesellschaft  
für Materialkunde e.V.

[www.dgm.de/verbund](http://www.dgm.de/verbund)

---

## Vorwort

Das traditionsreiche Symposium, das der Gemeinschaftsausschuss „Verbundwerkstoffe“ seit 1972 zum 15. Mal, diesmal an der Universität Kassel, veranstaltet, umfasst dieses Jahr über 120 Beiträge und 8 Plenarvorträge. Die Vortrags- und Diskussionstagung mit ihrer gleichzeitig stattfindenden Ausstellung hat sich zweifellos als das maßgebliche Forum für eine umfassende Betrachtung der Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde und ihrer weit verzweigten Einsatzgebiete etabliert.

Das Symposium gibt Impulse zur Beschleunigung des Innovationsgeschehens von der Wissensinnovation zur Produktinnovation. Es verknüpft in idealer Weise die universitäre und außeruniversitäre Forschung mit der industriellen Entwicklung. Nutzen Sie die Gelegenheit der interdisziplinären Wissenserweiterung und der Kontaktpflege in einer kulturell attraktiven Umgebung.

Das Symposium 2005 ist das große Ereignis der deutschen Verbundwerkstoff- und Werkstoffverbundszene – ein Muss für jeden, der mit Werkstofffragen konfrontiert ist.

*Michael Schlimmer*  
Tagungsleiter  
Institut für Werkstofftechnik,  
Universität Kassel

---

## Plenarvorträge

### **Aufgaben der zerstörungsfreien Prüfung im Rahmen eines Qualitätsmanagements**

H.-A. Crostack, Universität Dortmund

### **Herausforderung für die Bauteilprüfung durch den Einsatz neuer Verbundwerkstoffe**

H. Höninger, IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH, Dresden

### **Automobilwerkstoffe im Spannungsfeld der Umweltpolitik**

R. Hoock, M. Essenspreis, BMW AG, München

### **Materials go Sailing**

J.-A.E. Manson, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (CH)

### **Synchrotronstrahlung zur Charakterisierung von Metallmatrix-Verbundwerkstoffen**

A. Pyzalla, Technische Universität Wien (A)

### **SSP Rotorblätter**

R. Schytt-Nielsen, SSP Technology A/S, Broby (DK)

### **Die Hochtemperatur-Brennstoffzelle (SOE) - direkte Energiewandlung mit einem mehrlagigen Werkstoffverbund**

D. Stöver, H.P. Buchkremer, F. Tietz, Forschungszentrum Jülich GmbH

### **Bio- Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde in der Medizintechnik**

G. Ziegler, Universität Bayreuth

---

# Themen

## Grundlagen

- A:** PMC Polymer-Matrix-Verbundwerkstoffe
- B:** MMC Metall-Matrix-Verbundwerkstoffe
- C:** CMC Keramik-Matrix-Verbundwerkstoffe
- E:** Gradientenwerkstoffe
- F:** Schichtstrukturen
- G:** Nanocomposites
- H:** Modellierung und Simulation
- K:** Grenzflächenphänomene
- P:** Werkstoffprüfung

## Anwendung

- M:** Verbunde mit zellularen Strukturen
- U:** Anwendung in der Luft- und Raumfahrt
- W:** Automobilbau, insbesondere Serienfertigung und Recycling
- X:** Anwendung im Bauwesen
- Y:** Strukturelles Kleben

---

# Programmübersicht

	Mittwoch 6. April	Donnerstag 7. April	Freitag 8. April
<b>Vormittag</b>	Fachausschuss- sitzung MMC	M   C   Y E	F   H   W
<b>Nachmittag</b>	B   C   K G   A P	B   H   U X Postervorträge	
<b>Abend</b>	Begrüßung im Herkules Museum	Kommunikativer Abend im Foyer	

---

# Programmausschuss

## **M. Schlimmer (Vorsitz)**

Universität Kassel, Institut für  
Werkstofftechnik

## **A. Bledzki**

Universität Kassel, Institut für  
Werkstofftechnik Kunststoff- und  
Recyclingtechnik

## **A.R. Boccaccini**

Imperial College of Science,  
Technology and Medicine,  
Department of Materials,  
London (UK)

## **H.P. Degischer**

TU Wien, Institut für Werkstoffkunde  
und Materialprüfung (A)

## **E. Fehling**

Universität Kassel, Fachgebiet  
Massivbau

## **G. Grathwohl**

Universität Bremen, Keramische  
Werkstoffe und Bauteile

## **K.U. Kainer**

GKSS-Forschungszentrum  
Geesthacht GmbH, Institut für  
Werkstoffforschung

## **G. Leonhardt**

ProCon GmbH, Chemnitz

## **E. Lugscheider**

RWTH Aachen, Lehr- und  
Forschungsgebiet Werkstoff-  
wissenschaften

## **A. Matzenmiller**

Universität Kassel, Institut für  
Mechanik

## **W. Paatsch**

BAM, Materialschutz; zerstörungs-  
freie Prüfung, Berlin

## **P.P. Schepp**

Deutsche Gesellschaft für  
Materialkunde e.V., Frankfurt

## **K. Schulte**

TU Hamburg-Harburg, Arbeitsbereich  
Kunststoffe und Verbundwerkstoffe

## **B. Wielage**

TU Chemnitz, Lehrstuhl für  
Verbundwerkstoffe

## **G. Ziegler**

Universität Bayreuth, Friedrich-  
Baur-Forschungsinstitut für  
Biomaterialien

---

# Veranstalter

## **Gemeinschaftsausschuss Verbundwerkstoffe, GAV**

- Deutsche Glastechnische  
Gesellschaft e.V., Offenbach
- Deutsche Gesellschaft für  
Materialkunde e.V., Frankfurt
- Deutsche Gesellschaft für  
Galvano- und Oberflächen-  
technik e.V., Hilden
- Deutsche Keramische  
Gesellschaft e.V., Köln
- Deutscher Verband für  
Schweißen und verwandte  
Verfahren e.V., Düsseldorf
- VDI-Gesellschaft Werkstoff-  
technik e.V., Düsseldorf

---

# Tagungsorganisation

Deutsche Gesellschaft für  
Materialkunde e.V.  
Anja Mangold  
Christa Wendt  
Senckenberganlage 10  
60325 Frankfurt  
Tel: +49-69-75306 747  
Fax: +49-69-75306 733  
Home Office Tel: +49-6173-805076  
Home Office Fax: +49-6173-805077  
E-Mail: [verbund@dgm.de](mailto:verbund@dgm.de)



Universität Kassel, Institut für Werkstofftechnik

---

## Allg. Information

### Teilnahmebedingungen

Die Anmeldung zur Teilnahme sollte vorzugsweise über das Internet erfolgen. Ist kein Internetzugang möglich, bitten wir die Anmeldung auf der beiliegenden Anmeldekarte vorzunehmen. Für jeden Teilnehmer ist eine gesonderte Anmeldekarte erforderlich. Nach Eingang der Anmeldung erhalten die Teilnehmer eine Rechnung. In der Teilnahmegebühr enthalten sind die Pausengetränke, das Mittagessen am Mittwoch und Donnerstag und der Kommunikative Abend. Der Tagungsband muss gesondert bestellt werden.

Eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25% der Teilnahmegebühr wird in Rechnung gestellt, wenn ein angemeldeter Teilnehmer verhindert ist, an der Tagung teilzunehmen. Bei Stornierung nach dem 24. März 2005 muß die volle Teilnahmegebühr bezahlt werden. Ein Ersatzteilnehmer kann jederzeit gestellt werden.

### Posterbeiträge

Posterbeiträge können über die Tagungshomepage weiterhin eingereicht werden:

**[www.dgm.de/verbund](http://www.dgm.de/verbund)**

### Beginn/Ende der Veranstaltung

Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch um 13:00 Uhr und endet am Freitag um 13:00 Uhr.

---

## Tagungsort

### Veranstaltungsort

Universität Kassel  
Gebäude TIII/2  
Kurt-Wolters-Str. 3  
34125 Kassel  
<http://www.uni-kassel.de>

### Hotelinformationen

Eine Liste von Hotels finden Sie auf der Homepage der

kassel tourist GmbH  
Obere Königsstraße 15  
34117 Kassel  
Tel.: 0561-707707  
Fax: 0561-7077-169  
<http://www.kassel-tourist.info>

Geben Sie bitte bei der Reservierung das Stichwort: „Verbund 2005“ an.

---

## Ausstellung

### Industrieausstellung als Kommunikationsplattform

Unternehmen und Institute sind willkommen, ihre Produkte und Dienstleistungen auf der mit der Tagung verbundenen Industrieausstellung zu präsentieren.

# Verbund 2005

15. Symposium  
Verbundwerkstoffe und  
Werkstoffverbunde

## Anmeldung

Online: [www.dgm.de/verbund](http://www.dgm.de/verbund)

Fax: +49-69-75306-733

.....  
Name, Vorname, Titel

.....  
Universität / Firma

.....  
Institut / Abteilung

.....  
Straße

.....  
Land, PLZ, Ort

.....  
Tel. / Fax

.....  
Email:

---

01	<input type="checkbox"/> Teilnahmegebühr, Industrie	EUR 590,-
02	<input type="checkbox"/> Teilnahmegebühr, Universität	EUR 420,-
03	<input type="checkbox"/> weitere Teilnehmer aus dem gleichen Institut	EUR 360,-
04	<input type="checkbox"/> Studentische Teilnehmer (bis 28 Jahre) Kopie Studentenausweis beifügen	EUR 200,-
05	<input type="checkbox"/> Begrüßungsabend	EUR 10,-
06	<input type="checkbox"/> Kommunikativer Abend	inkl.
07	<input type="checkbox"/> Tagungsband Bestellungen bis 6. März 2005 können garantiert werden.	EUR 95,-
08	<input type="checkbox"/> Tagungsband im Internet (PDF)	inkl.

---

Ich zahle per:  MasterCard  
 Visa  
 Überweisung

Ich erhalte eine Rechnung nach Eingang  
der Anmeldung.

.....  
KPN  
(die letzten 3 Ziffern  
auf der Rückseite der  
Kreditkarte)

.....  
Kreditkarten Nr.

.....  
Gültigkeitsdatum

.....  
**unbedingt erforderlich! Datum und Unterschrift**